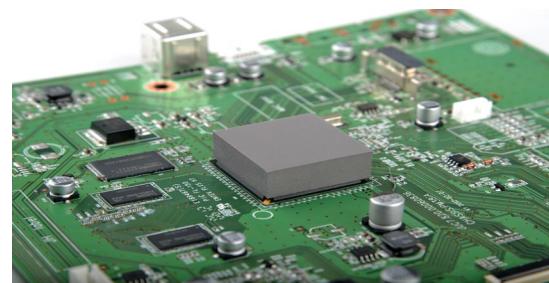


高导热硅胶垫片

TP1500-Q是一款无交联的高导热有机硅导热垫片，导热系数 $15\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，无交联状态使其没有橡胶的回弹性，但是具有非常好的压缩性且高压缩后应力非常小，易于装配。



特性和优点

- 导热系数: $15.0\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- 超柔软
- 无交联
- 高电气绝缘
- 韧性好易操作
- 高压缩率

典型应用

- 电压调节模块 (VRMs)
- IGBT
- 高导热需求模块
- 高热量BGAs
- 电信设备
- 网络通信设备

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	灰色	目视
厚度(mm)	0.5~5.0	ASTM D374
密度(g/cc)	3.2	ASTM D792
硬度(Shore 00)	40	ASTM D2240
耐温范围($^{\circ}\text{C}$)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
存储保质期(月)	12	温度 $<40^{\circ}\text{C}$ 避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥ 5.0	ASTM D149
介电常数	7.0	ASTM D150
体积电阻率($\Omega\cdot\text{cm}$)	10^{12}	ASTM D257
导热性能		
导热系数($\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)	15	ISO 22007-2
热阻($^{\circ}\text{C}\cdot\text{in}^2/\text{W}$ @50psi)	≤ 0.065	ASTM D5470